

# 2024年日本9月电子零部件检测设备及开发技术展

产品名称	2024年日本9月电子零部件检测设备及开发技术展
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	99.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

## 产品详情

2024日本电子科技博览会NEPCON JAPAN

### 【基本信息】

展会时间：2024年01月24-26日；东京Big Sight 展览馆

展会时间：2024年09月04-06日：东京千叶幕张展览馆

展会时间：2024年10月23-25日：名古屋展馆

展会规模：约1200家参展商；参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

### 展会介绍

亚洲领先电子研发，制造与封装技术展会，作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个专业展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”醉新技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

## 展览范围

- 1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备
- 2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务
- 3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备
- 4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料
- 5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备
- 6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

## 展会补贴

温馨提示:展位补贴高，展会效果好，价格优,补贴额度50%-80% (. 上海地区--个展位补贴2万，江苏地区--个展位补贴70%,除南京补贴80%外，其他地区均是70%,福建地区展位部分地区全补的)

## 我司全程负责

展位安排、搭建装修、展具租赁;人员签证、往返国际机piao、接机送机、店住宿、--日三餐、境外专车接送、旅游观光、翻译、司机导游等一条龙服务,让您轻松参展，欢迎各相关企业踊跃报名，展会补贴等!

## 参展服务

- 1.组团赴日参加展会，全程为展商服务，团队统一负责人员的\*\*机piao、邀请函及签证手续、酒店住宿、餐饮、接机送机、导游司机、观光旅游等一条龙服务；
- 2.为客户上传样品照片，参展商可以提供样品的照片，官方发布到网站上，日本客商\*直接有效的了解贵公司产品信息，有利于在日本市场上销售。
- 3.为展商提供翻译聘请、展具租赁、货运、展品运输等服务；
- 4.为展商提供日本市场行情以及与日本客户外贸常识等咨询服务；
- 5.凡是参加我公司组织展会，均可申请国家补贴，展会的补贴的额度为50%--\*\*之间，根据每个地区和国家政策，不同区域补贴额度不一样的。